(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年2月10日(10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/013360 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 23/12

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011279

(22) 国際出願日:

2004年7月30日(30.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-206098

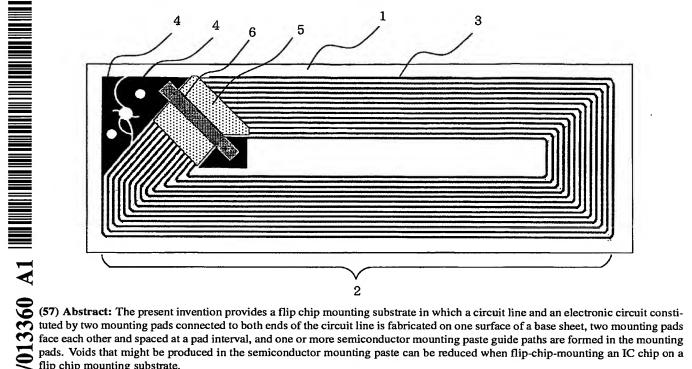
2003年8月5日(05.08.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リン テック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都 板橋区 本町 2 3-2 3 Tokyo (JP).

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中田 安一 (NAKATA, Yasukazu) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都 板 橋区 本町 2 3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 松浦 勝良 (MATSUURA, Katsuyoshi) [JP/JP]; 〒 173-0001 東京都 板橋区 本町 23-23 リンテック株 式会社内 Tokyo (JP). 松下 大雅 (MATSUSHITA, Taiga) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都 板橋区 本町 2 3-2 3 リ ンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 折口 信五 (ORIGUCHI, Shingo); 〒105-0003 東京都 港区 西新橋一丁目14番7号 西新橋杉浦ビ ル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

- (54) Title: FLIP CHIP MOUNTING SUBSTRATE
- (54) 発明の名称: フリップチップ実装用基板



pads. Voids that might be produced in the semiconductor mounting paste can be reduced when flip-chip-mounting an IC chip on a flip chip mounting substrate.

(57) 要約: 本発明は、基材シートの一方の表面に、回路線及び該回路線の両末端に接続する2つの実装パッドからな ▼ る電子回路が設けられ、2つの実装パッドがパッド間隙を隔てて対向しており、その実装パッドに半導体実装ペース ト誘導路が1以上設けられているフリップチップ実装用基板を提供する。本発明のフリップチップ実装用基板は、 フリップチップ実装用基板にICチップをフリップチップ実装する際、半導体実装ペースト中に発生するボイドを低 減することができる。

WO 2005/013360 A1

A TERRE BUILDIN IN BURIND WOM BOWN BOWN BOWN AND IN AN OUR BURIND WAS IN A BURIND BURN BURN BURN BURN BOWN HER

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。